



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2026年8月10日

上場取引所 東 名

上場会社名 竹田 i Pホールディングス株式会社

コード番号 7875 URL <https://www.takedaip-hd.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 C00 (氏名) 細野 浩之

問合せ先責任者 (役職名) 上席執行役員 CFO 経営統括本部長 (氏名) 巻尾 忠臣 TEL 052-871-6351

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無：無

決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績（2026年4月1日～2026年6月30日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期第1四半期	8,199	3.9	236	23.8	281	29.4	500	230.0
2026年3月期第1四半期	7,893	6.4	190	212.5	217	109.6	151	—

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 1,068百万円 (681.4%) 2026年3月期第1四半期 136百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	29.91	—
2026年3月期第1四半期	9.10	—

(注) 当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2027年3月期第1四半期	34,832	20,788	59.3	1,234.72
2026年3月期	34,654	19,998	57.3	1,187.40

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 20,648百万円 2026年3月期 19,857百万円

(注) 当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産」を算定しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	14.00	—	33.00	47.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期 (予想)	—	7.00	—	16.50	23.50

(注) 当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2026年3月期については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。2027年3月期（予想）については、当該株式分割後の数値を記載しております。

直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

3. 2027年3月期の連結業績予想（2026年4月1日～2027年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期（累計）	16,800	5.6	490	8.2	508	△0.6	651	52.5	38.88
通期	36,000	4.4	1,630	25.1	1,624	11.6	1,450	30.1	86.48

（注）当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2027年3月期の連結業績予想における「1株当たり当期純利益」については、当該株式分割の影響を考慮しております。

直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更：無

新規 一社 （社名）－、除外 一社 （社名）－

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料P.7「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2027年3月期1Q	17,562,000株	2026年3月期	17,562,000株
② 期末自己株式数	2027年3月期1Q	838,642株	2026年3月期	838,642株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2027年3月期1Q	16,723,358株	2026年3月期1Q	16,652,417株

（注）当社は、2026年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算出しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー：無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.3「1. 経営成績等の概況（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)	7
(セグメント情報等の注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	8
(重要な後発事象)	8

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景として緩やかな回復基調が続いたものの、米国を中心とした通商政策の動向、世界経済の減速懸念、地政学的リスクの高まり、為替相場及び原材料価格の変動などにより、先行きは依然として不透明な状況が続きました。一方、AI関連投資やデータセンター需要の拡大を背景として、半導体関連市場では、中長期的な需要拡大が期待される状況が続いております。

このような経営環境のもと、当社グループは、中期経営計画の最終年度として、既存事業の収益力強化及び事業構造改革を進めるとともに、半導体関連マスクセグメントを重要な成長領域と位置付け、BPO・DX領域及びグローバルパッケージ事業を含む成長分野への投資を継続し、事業ポートフォリオの変革を推進しました。

また、政策保有株式の売却や低稼働資産の処分を進めるなど、資産の入れ替えを通じて経営資源の有効活用を図り、収益力及び資本効率の向上に取り組みました。

さらに、半導体関連分野における事業領域の拡大及び競争力の強化を目的として、2026年7月13日付で大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得し、子会社化いたしました。同社が有するプリント基板の回路設計、基板電気検査等の技術及び顧客基盤と、当社グループの半導体関連事業とのシナジー創出を図ってまいります。なお、同社の業績は当第1四半期連結会計期間には含まれておらず、第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含める予定であります。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は81億99百万円（前年同期比3.9%増）となりました。このうち、海外売上高は8億40百万円（前年同期比2.6%減）となり、海外売上高比率は10.2%（前年同期は10.9%）となりました。また、営業利益は2億36百万円（前年同期比23.8%増）、経常利益は2億81百万円（前年同期比29.4%増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、政策保有株式及び低稼働資産の売却に伴う特別利益を計上したことなどにより、前年を大幅に上回る5億円（前年同期比230.0%増）となりました。

セグメント別の状況は、以下のとおりです。

(情報コミュニケーション)

情報コミュニケーションでは、商業印刷を中心とする印刷事業、グローバルパッケージ事業、BPO・ロジスティクス、DX・マーケティング支援、システム開発及びプロモーション支援などを通じて、顧客の課題解決を総合的に支援しております。

当第1四半期連結累計期間においては、印刷市場の縮小や原材料価格、人件費等の上昇が続くなか、既存顧客への提案強化、新規顧客の開拓、高付加価値案件の獲得及び生産性の向上に取り組みました。

印刷事業では、印刷需要の減少等により売上高は前年同期を下回りました。一方、価格改定の浸透、案件構成の改善及び生産効率の向上等により、収益性の改善に取り組みました。

ロジスティクス（BPOサポート）事業では、受発注管理システム「TS-BASE」の新規導入及び既存顧客への追加提案を進めるとともに、BPO案件の獲得に取り組みました。

グローバルパッケージ事業では、タイの新工場における生産体制の安定化並びに品質及び生産効率の向上に取り組むとともに、現地及び周辺地域における顧客開拓を進めました。

以上の結果、情報コミュニケーションセグメントの売上高は36億80百万円（前年同期比3.6%減）となりました。一方、価格改定や生産性向上等の効果により、営業利益は23百万円（前年同期比14.6%増）となりました。

(ソリューションセールス)

ソリューションセールスでは、印刷機械、印刷資材及び関連商品の販売に加え、顧客の生産性向上、省力化及び環境負荷低減等の課題に対応した機器、資材及びサービスの提案を行っております。

当第1四半期連結累計期間においては、全国の営業拠点を活用した提案活動を強化するとともに、展示会やセミナー等を通じて、自社ブランド製品及び新商品の拡販に取り組みました。

また、資材、機材及びサービスの各分野において、顧客ニーズに応じた営業活動を推進するとともに、収益性を重視した商品構成の見直し及び新たな商材・サービスの拡充に取り組みました。

以上の結果、資材等の販売が増加したことなどにより、ソリューションセールスセグメントの売上高は28億84百万円（前年同期比7.6%増）、営業利益は61百万円（前年同期比35.8%増）となりました。

(半導体関連マスク)

半導体関連マスクセグメントは、当社グループの中長期的な収益拡大を担う中核事業であり、事業ポートフォリオの変革を推進する重要な成長領域と位置付けております。

当第1四半期連結累計期間においては、AIサーバーやデータセンター関連投資の拡大を背景として、一部の半導体及び電子部品関連需要は堅調に推移した一方、中国経済の停滞や自動車・EV関連市場の回復の遅れなどにより、用途や地域によって需要にばらつきがみられました。

このような環境のもと、国内2社及び中国・東南アジアの海外3社が連携し、成長市場における受注拡大、技術開発、生産能力の強化及び顧客基盤の拡大に取り組みました。

竹田東京プロセスサービス株式会社では、新規顧客及び新規案件の獲得、生産設備の有効活用並びに生産性の向上を進めました。株式会社プロセス・ラボ・ミクロンでは、中部テクノロジーセンター閉鎖後の生産移管効果を生かし、固定費の削減、内製化及び生産効率の向上を推進しました。

海外では、中国、タイ及びベトナムの各拠点において、地域ごとの需要動向に対応した営業活動及び生産体制の最適化を進めるとともに、国内拠点との技術・生産面での連携を強化しました。

以上の結果、国内外における半導体及び電子部品関連需要を取り込んだことに加え、生産移管、内製化及び生産効率向上の効果もあり、半導体関連マスクセグメントの売上高は17億13百万円（前年同期比18.1%増）、営業利益は1億47百万円（前年同期比29.4%増）となりました。

なお、2026年7月13日付で子会社化した大英エレクトロニクス株式会社の業績は、当第1四半期連結会計期間には含まれておらず、第2四半期連結会計期間より連結の範囲に含める予定であります。

(不動産賃貸)

不動産賃貸では、当社グループが保有する土地及び建物等を有効活用し、安定的な賃貸収入の確保に努めました。一部賃貸物件の減少等により、不動産賃貸セグメントの売上高は1億78百万円（前年同期比8.4%減）、営業利益は1億3百万円（前年同期比12.7%減）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は348億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億77百万円増加しました。

流動資産は150億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億1百万円減少しました。これは、政策保有株式及び低稼働資産の売却等により現金及び預金が増加した一方、受取手形及び売掛金がそれを上回って減少したことなどによるものです。

固定資産は197億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億79百万円増加しました。これは主として、政策保有株式の売却を進めた一方、保有株式の市場価格の上昇に伴う時価評価額の増加が売却による減少を上回り、投資有価証券が増加したことによるものです。

当社グループでは、政策保有株式及び低稼働資産の売却を継続し、資産構成の最適化を進めております。このため、当第1四半期連結会計期間末においては、資産売却により創出された資金が一時的に現金及び預金として積み上がっております。

なお、2026年7月13日付で大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得しており、当該株式取得に伴う資金支出は第2四半期連結会計期間に反映されます。当社グループは、資産の入れ替えを通じて創出した経営資源を成長投資等へ配分し、収益力及び資本効率の向上に取り組んでまいります。

負債は140億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億11百万円減少しました。これは主として、支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。

純資産は207億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億89百万円増加しました。これは主として、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上及び保有株式の市場価格の上昇に伴うその他有価証券評価差額金の増加があった一方、剰余金の配当を実施したことによるものです。

以上の結果、自己資本比率は59.3%となり、前連結会計年度末の57.3%から2.0ポイント増加しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2026年7月13日付で大英エレクトロニクス株式会社を子会社化したことに伴い、第2四半期連結会計期間より同社の業績を連結業績に取り込む予定であります。また、資産構成の最適化の一環として進めている政策保有株式及び低稼働資産の売却に伴う特別利益を見込んでおります。これらの影響に加え、当第1四半期連結累計期間の業績動向を総合的に勘案した結果、2026年5月14日に公表した2027年3月期の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日公表しております「第2四半期（中間期）及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年 3 月 31 日)	当第 1 四半期連結会計期間 (2026年 6 月 30 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,282	6,780
受取手形及び売掛金	5,305	4,451
電子記録債権	1,732	1,561
有価証券	100	-
商品及び製品	665	808
仕掛品	404	465
原材料及び貯蔵品	474	517
その他	791	567
貸倒引当金	△70	△67
流動資産合計	15,686	15,084
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	3,756	3,739
機械装置及び運搬具（純額）	1,272	1,256
土地	5,925	5,917
リース資産（純額）	1,341	1,558
建設仮勘定	1,197	1,053
その他（純額）	416	405
有形固定資産合計	13,909	13,931
無形固定資産	646	649
投資その他の資産		
投資有価証券	3,647	4,486
繰延税金資産	180	105
その他	728	720
貸倒引当金	△144	△144
投資その他の資産合計	4,411	5,167
固定資産合計	18,968	19,748
資産合計	34,654	34,832

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年 3 月 31 日)	当第 1 四半期連結会計期間 (2026年 6 月 30 日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,845	2,195
電子記録債務	2,855	2,913
短期借入金	730	730
1 年内返済予定の長期借入金	593	591
リース債務	345	378
未払法人税等	237	239
賞与引当金	589	700
その他の引当金	71	20
その他	1,754	1,301
流動負債合計	10,022	9,070
固定負債		
長期借入金	670	600
リース債務	1,103	1,274
長期未払金	138	156
退職給付に係る負債	1,601	1,607
資産除去債務	235	237
その他	883	1,096
固定負債合計	4,633	4,972
負債合計	14,655	14,043
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,937	1,937
資本剰余金	1,809	1,809
利益剰余金	13,830	14,054
自己株式	△305	△305
株主資本合計	17,272	17,496
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,746	2,345
為替換算調整勘定	514	498
退職給付に係る調整累計額	324	307
その他の包括利益累計額合計	2,584	3,151
非支配株主持分	141	139
純資産合計	19,998	20,788
負債純資産合計	34,654	34,832

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月30日)
売上高	7,893	8,199
売上原価	6,199	6,414
売上総利益	1,694	1,784
販売費及び一般管理費	1,503	1,547
営業利益	190	236
営業外収益		
受取配当金	38	48
貸倒引当金戻入額	5	13
その他	7	12
営業外収益合計	51	74
営業外費用		
支払利息	8	19
為替差損	14	6
その他	1	2
営業外費用合計	24	29
経常利益	217	281
特別利益		
固定資産売却益	90	3
投資有価証券売却益	1	460
その他	—	2
特別利益合計	91	466
特別損失		
固定資産処分損	3	0
会員権評価損	—	2
特別損失合計	3	3
税金等調整前四半期純利益	306	744
法人税等	153	243
四半期純利益	152	501
非支配株主に帰属する四半期純利益	0	0
親会社株主に帰属する四半期純利益	151	500

(四半期連結包括利益計算書)

(単位：百万円)

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月30日)
四半期純利益	152	501
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	111	599
為替換算調整勘定	△116	△15
退職給付に係る調整額	△11	△17
その他の包括利益合計	△15	567
四半期包括利益	136	1,068
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	136	1,068
非支配株主に係る四半期包括利益	0	0

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理に関する注記)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第 1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第 1 四半期連結累計期間（自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				計	調整額 (注) 1	四半期連結損 益計算書計上 額 (注) 2
	情報コミュニ ケーション	ソリューショ ンセールス	半導体関連 マスク	不動産賃貸			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	3,812	2,611	1,450	19	7,893	—	7,893
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	7	70	—	174	252	△252	—
計	3,819	2,682	1,450	194	8,146	△252	7,893
セグメント利益	20	45	113	118	297	△106	190

(注) 1. セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去及び各事業セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第 1 四半期連結累計期間（自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント				計	調整額 (注) 1	四半期連結損 益計算書計上 額 (注) 2
	情報コミュニ ケーション	ソリューショ ンセールス	半導体関連 マスク	不動産賃貸			
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	3,672	2,793	1,713	19	8,199	—	8,199
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	8	91	—	158	257	△257	—
計	3,680	2,884	1,713	178	8,456	△257	8,199
セグメント利益	23	61	147	103	334	△98	236

(注) 1. セグメント利益の調整額には、セグメント間取引の消去及び各事業セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、事業セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第 1 四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第 1 四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

	前第 1 四半期連結累計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 6 月30日)	当第 1 四半期連結累計期間 (自 2026年 4 月 1 日 至 2026年 6 月30日)
減価償却費	213百万円	278百万円

(重要な後発事象)

(株式取得による企業結合)

当社は2026年 6 月17日開催の取締役会において、ムトー精工株式会社から、同社の子会社である大英エレクトロニクス株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、2026年 6 月17日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、当社は2026年 7 月13日付で株式を取得しております。

1. 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業内容

被取得企業の名称：大英エレクトロニクス株式会社

事業の内容：プリント基板回路設計、基板電気検査、3D-MID設計サービス

(2) 企業結合を行う主な理由

当社グループは、印刷事業を祖業とし、現在では情報コミュニケーション、ソリューションセールス、半導体関連マスク、不動産賃貸等の事業を展開しております。当社グループの半導体関連マスク事業は、当社（旧竹田印刷株式会社）において、製版技術を応用した新規事業として1987年に開始しました。その後、M&A等を通じて事業規模を拡大し、現在では、事業会社である竹田東京プロセスサービス株式会社及び株式会社プロセス・ラボ・ミクロンを中核として、グループの重要な事業セグメントへと成長しております。現在は、電子部品向け精密工業用写真製版（スクリーンマスク、フォトマスク）及び電子部品実装用各種マスクの製造・販売、ならびにこれらに付随する業務を展開しており、中国、タイ及びベトナムへと事業展開を進め、当社グループの成長分野として、さらなる事業領域の拡大を図っております。

大英エレクトロニクス株式会社は、プリント配線板の基板設計及びプリント配線板等の検査サービスを主たる事業としております。設計部門においては、経験豊富な設計者が多数在籍し、設計ノウハウが組織として蓄積・共有されていることから、高い設計対応力を有しております。また、検査サービスについても、プリント配線板等に関する知見及び顧客基盤を有しており、当社グループの半導体関連マスク事業との親和性が高いものと認識しております。

本件株式取得により、大英エレクトロニクス株式会社の設計・検査に関する人材、技術及びノウハウと、当社グループが有する製造技術、設計・製造ノウハウ並びに国内外の顧客基盤を組み合わせることで、基板設計からマスク製造・検査に至る提案力の強化、顧客ニーズへの対応力向上、及び当社グループが製造・販売するフォトマスク、スクリーンマスク等の受注機会の拡大が期待できるものと考えております。

また、当社グループと大英エレクトロニクス株式会社は共通する顧客基盤を有していることから、既存顧客に対する提案領域の拡大と取引関係の一層の深化が可能と考えております。

このように、当社グループの半導体関連マスク事業と大英エレクトロニクス株式会社の事業は、技術領域・顧客領域の両面で重なりが大きく、高い親和性を有していることから、相互にシナジーを発揮することができ、より持続的かつ安定的な成長を図ることが可能であると考えており、本件株式取得は、当社グループの事業領域の拡大及び企業価値の向上に資するものと判断いたしました。

(3) 企業結合日

2026年 7 月13日

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

大英エレクトロニクス株式会社

(6) 取得する議決権比率

100%

大英エレクトロニクス株式会社の発行済株式数160,000株のうち、自己株式3,560株を除いた156,440株を当社が取得し同社を100%子会社といたしました。

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金	2,289百万円
-------	----	----------

取得原価	2,305百万円
------	----------

3. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 16百万円

4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

(固定資産の取得)

当社は2024年 3 月18日開催の取締役会において、固定資産を取得することについて決議し、2024年 5 月27日に当該固定資産の取得に関する不動産売買契約を締結しておりましたが、2026年 7 月 3 日に引渡しが完了いたしました。

1. 取得の目的

竹田iPグループ本社移転を目的とするものであります。

2. 取得資産の内容

(1) 固定資産の種類 土地及び建物

(2) 所在地 名古屋市中区

(3) 土地面積 3,546.46㎡

(4) 取得価額 2,910百万円